

中国电子装备技术开发协会

中电协【2026】560号

关于《苯并环丁烯树脂在半导体先进封装应用指南》等两项团体标准 立项通知

各有关单位：

根据民政部印发的《团体标准管理规定》和中国电子装备技术开发协会《团体标准工作管理办法》等相关文件要求，由绵阳高新区达高特科技有限公司、牵头起草并申报的《苯并环丁烯树脂在半导体先进封装应用指南》、《苯并环丁烯(BCB)单体》两项团体标准，经我会评审，以上标准符合立项条件，现批准立项。

立项号：

2026-311T-CAEE 《苯并环丁烯树脂在半导体先进封装应用指南》

2026-312T-CAEE 《苯并环丁烯(BCB)单体》

请起草单位按照团体标准管理相关要求，严格把控标准质量关，切实提高标准制定水平，增加标准的适用性和实效性，按期完成标准编制工作。

联系人：张老师

联系电话：010-63728479 15110020951

协会监督：010-58892027

中国电子装备技术开发协会

2026年8月19日

